



Advanced Semiconductor Engineering Inc.

TDK 株式会社

ASE 社と TDK の IC 内蔵基板製造事業合弁契約の締結に関するお知らせ

携帯端末・ウェアラブル端末における半導体小型化のデファクトスタンダードを確立する
マーケット・リーダーを目指す

2015 年 5 月 8 日

Advanced Semiconductor Engineering Inc.（代表者：Jason C.S. Chang 会長兼 CEO、所在地：台湾国高雄市、TAIEX: 2311、NYSE: ASX、以下 ASE 社）と TDK 株式会社（代表取締役社長：上釜 健宏）は、TDK の「SESUB[®]」技術を使用した IC 内蔵基板を製造するための合弁会社の設立について、本日、合弁契約を締結したことをお知らせします。新会社への出資比率は、ASE 社が 51%、TDK が 49%となります。社名は「日月暘電子股份有限公司」とし、台湾国高雄市の Nantze Export Processing Zone に製造施設を設置する予定です。

当合弁会社は、これまで TDK が市場において SESUB 技術を確立した実績と ASE 社の半導体小型化に向けた高度な IC パッケージ能力およびテスト・ソリューション能力を活用したビジネスモデルを展開します。TDK の IC 内蔵基板 SESUB 技術は、得意とするインダクティブデバイスや HDD 用磁気ヘッドの製造にて培った独自の微細加工技術と材料技術を結集して開発されました。SESUB は IC チップを 50 μ m まで薄く加工し、樹脂基板内に内蔵しますが、4 層の樹脂基板内に IC を内蔵することが可能です。集積 IC チップ全体の厚みでも僅か 300 μ m と非常に薄くなっています。

SESUB 技術を使うことにより、基板上の実装面積の低減による小型化、厚み 300 μ m の実現による薄型化、良好な放熱性による設計自由度の向上、そして高い EMI 効果を実現するチップ間接続が可能になる等、多くのメリットを得ることができます。

TDK の上釜健宏・代表取締役社長は、「スマートフォンやウェアラブル端末は、今後一層の小型化、軽量化が必要とされることから、SESUB をはじめとする IC 内蔵基板の需要がグローバル規模で増加していく見込みです。」と述べました。また、「当社は従来、SESUB を日本の甲府工場にて生産してまいりましたが、今後増加して行く需要に対応するため、同製品の生産拡大に向けて、IC パッケージ組立などの技術を有し、テストにおいては世界トップの実績を誇る ASE 社と合弁会社を台湾に設け、本格的な量産を行う体制を整えることとしました。」と上釜社長はコメントしました。

ASE グループ COO の Tien Wu 博士は、「ASE 社は、消費者市場に携帯端末やウェアラブル端末を供給する大手企業数社を含む幅広い顧客と取引をしています。高度パッケージ・ソリューションと製品テストの専門知識を活用するシステム組込みパッケージ（SIP）インテグレーションの大手企業です。一方、TDK は、実績に裏付けされた独自の IC 内蔵基板技術を用いて、より多くの IC チップと機能のインテグレーション、パフォーマンスの向上、消費電力の低減、小型規格の放熱性といった市場ニーズに対応しています。私たちはこの強力な事業提携を ASE 社の SIP のエコシステムへの付加価値と捉えています。協業を通じて、共に、TDK の SESUB 技術を業界標準として推進していきます。」と述べました。

合併会社の概要について

1. 社名	ASE Embedded Electronics Inc. 日月暘電子股份有限公司
2. 所在地	台湾国高雄市 (ASE 社の高雄工場敷地内)
3. 資本金及び 出資比率	39,490,000 米ドル相当の台湾ドル ASE 社 : 51%、TDK : 49%
4. 主な事業	SESUB 製品ならびに IC 内蔵基板製品の製造

TDK 株式会社について

TDK 株式会社 (本社 : 東京) は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で 1935 年に設立されました。主な製品としては、各種受動部品※ (製品ブランドとしては TDK、EPCOS) をはじめ、電源、HDD ヘッドやマグネットなどの磁気応用製品、そしてエナジーデバイスやフラッシュメモリ応用デバイス等があります。アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。

2015 年 3 月期の売上は約 1 兆 800 億円で、従業員総数は全世界で約 88,000 人です。TDK は、台湾での研究開発活動の強化と台湾企業や研究機関との協力関係の拡大を進めてきました。TDK グループについては、詳しくはウェブサイトをご覧ください。 www.global.tdk.com

※主な製品は、コンデンサ (積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ)、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、センサ、ピエゾおよび保護部品等です。

ASE グループについて

ASE グループは、独立系の半導体製造サービスの世界最大手で、組立、製品テスト、材料、製造デザインなどのサービスを提供しています。業界では、より速く、より小さく、よりパフォーマンスの優れた IC チップに対するニーズがこれまでになく高まっています。グローバルリーダーとしてこのようなニーズに応えるために、ASE グループは、幅広い技術とソリューションのポートフォリオを開発・提供しています。このポートフォリオには、IC テストのプログラム・デザイン、前工程のエンジニアリングテスト、ウェーハ・プローブ、ウェーハ・バンプ、基板デザイン、基板供給、ウェーハ・レベルのパッケージ、フリップ・チップ、システム組込みパッケージ (SIP)、最終テスト、傘下の Universal Scientific Industrial Co Ltd. を通じて提供する電子製造サービスが含まれます。ASE グループは、2014 年の売上は 85 億米ドル、従業員数は全世界で 6 万 8 千人を超えます。

より詳しくは、こちらをご覧ください。 www.aseglobal.com

報道関係者の問い合わせ先

Advanced Semiconductor Engineering Inc.

担当者	所属	電話番号	Email Address
Ms. Jennifer Yuen	Advanced Semiconductor Engineering Inc.	+65 6631 4229	jennifer.yuen@aseus.com

TDK 株式会社

担当者	所属	電話番号	Email Address
大須賀	TDK 株式会社 広報グループ	+81 3 6852-7102	pr@jp.tdk.com